

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022 《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2022 《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共7项，其中自主可控 A 级7项、B 级项、C 级0项、C*级0项、D 级0项、E 级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。

深圳市台华达科技有限公司

单位名称(公章)

2023 年 11 月 22 日



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^f
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	FPC 连接器	THD05175-XXCL-GF 系列	深圳市台华达科技有限公司	A	否	无	否	无	否	无	
2	FPC 连接器	THD05175-XXCL-SN 系列	深圳市台华达科技有限公司	A	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

^b. 应填写元器件完整型号规格；

^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；

^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；

^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；

^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

填报单位(盖章): 深圳市台华达科技有限公司 法定代表人(签章): 黄德进 填表人(签字): 夏珍珍 电话: 18664572088 填报日期: 2023. 11. 28



附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^g		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	FPC 连接器	THD05175-XXCL-GF 系列	无	无	无	无	LCP UL94V-0	非“核心”	深圳市台华达科技有限公司	境内	无	无	
2	FPC 连接器	THD05175-XXCL-SN 系列	无	无	无	无	LCP UL94V-0	非“核心”	深圳市台华达科技有限公司	境内	无	无	

填表说明:

^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;

^b. 应填写元器件完整型号规格;

^c. 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;

^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;

^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;

^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;

^g. 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如 45nmBCD 工艺等, 必要时在备注中填写流片厂商信息。

填报单位(盖章): 深圳市台华达科技有限公司 法定代表人(签章): 黄德进 填表人(签字): 夏珍珍 电话: 18664572088 填报日期: 2023. 11. 28

